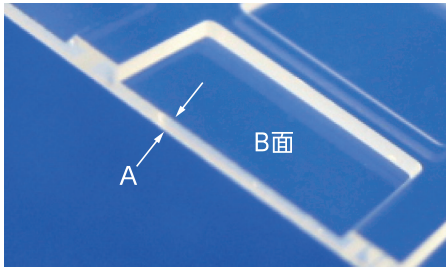
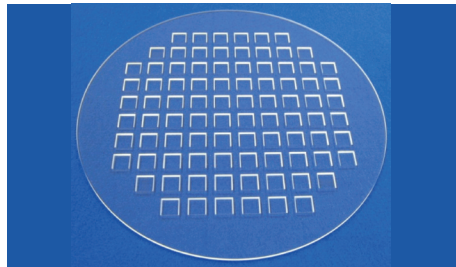


特殊加工ガラス



特殊加工ガラス

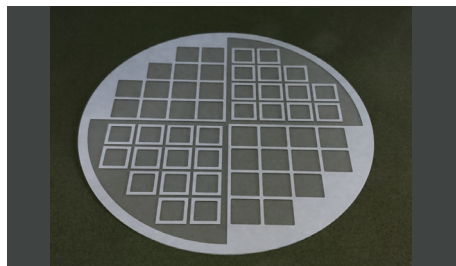
BT加工



製品基本仕様

ガラス材質	各種ガラス
ウエーハサイズ	～φ200mm
ウエーハ厚み	0.3～10mm
A寸法	0.02～10mm
厚み公差	±0.02mm
B面	光学面

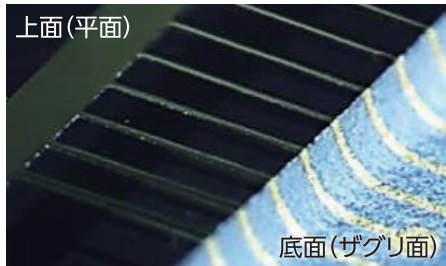
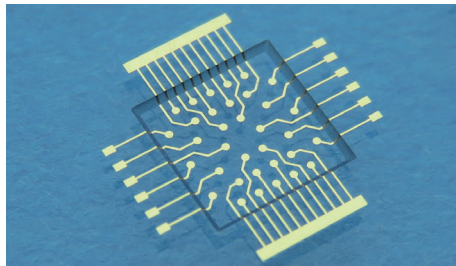
ガラス/Si一体加工



製品基本仕様

ガラス材質	TEMPAX 他
ウエーハサイズ	～φ200mm
ウエーハ厚み	0.3～2.0mm
平面度	< 0.1mm (φ200mm)
TTV	< 0.01mm
素材間段差	< 0.1μm

立体配線ガラス加工



製品基本仕様

ガラス材質	各種ガラス
ウエーハサイズ	～φ200mm
ウエーハ厚み	0.3～2.0mm
ザグリ深さ	～0.5mm
厚み公差	±0.02mm
メタライズ種類	Ti/Cr/Pt/Au

用途(事例)

- ・ 観察/分析チップ
- ・ イメージセンサ用キャップ
- ・ LD/LED光源キャップ
- ・ 遮光性ガラス基板
- ・ 高周波センサ/スイッチ
- ・ 半導体関連治具等

特徴

- ・ 電子機器/部品パッケージの小型化・高機能化
- ・ ガラス底面状態(透過性のある鏡面、ブラスト面、研削面 他)
- ・ 各種ガラス材質へ対応
- ・ 各種接合方法(陽極接合、フリット接合、接着材接合 他)
- ・ 立体面へのメタライズ配線加工が可能
- ・ 遮光性を向上する側壁メタライズやSi側壁基板も対応
- ・ ARコートなども対応